

株 主 通 信

S P R I N G 2 0 1 5

94号

2 0 1 5 年 3 月 期

第 3 四 半 期
決 算 報 告

Fit your needs, Fit your future

期待に応じて、未来を形に...

SCREEN NOW

株主の皆さまへ



平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2015年3月期第3四半期累計期間(2014年4月1日～12月31日)における事業環境は、半導体業界においては、スマートフォンの需要拡大を背景に、半導体メーカーの設備投資は堅調に推移しました。印刷関連機器においては、欧州市場に需要回復の動きが見られました。FPD業界においては、テレビ用液晶パネルの中国への生産シフトが進みました。

このような状況の中、当第3四半期累計期間の当社グループの売上高は1,623億円と前年同期に比べ9億円(0.6%)減少しました。利益面では、変動費の削減やセミコンダクターソリューション事業における製品構成の変化、たな卸資産評価損の減少などにより、営業利益は101億円(前年同期比122.2%増)、経常利益は93億円(前年同期比129.6%増)となりました。四半期純利益は78億円(前年同期比245.8%増)となりました。

2015年3月期の連結業績予想に関しましては、前回予想(2014年11月10日発表)から売上高を2,380億円に減額しましたが、一方、営業利益は固定費削減などにより3億円増額し、150億円を見込んでおります。配当につきましては、前回予想どおり1株当たり5円(期末配当金)を予定しております。

当社グループは、今後も、中期3カ年経営計画「Challenge2016」の達成に向けて、着実に高収益体質への変革を図ってまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取締役社長 最高執行責任者(COO)

垣内 永次

SCREEN



SCREENの「フロンティアプロジェクト」

当社グループは、半導体業界において、世界シェアNo.1の洗浄装置やコーターデベロッパーを中心に300mm ウエハー*に対応した最先端の半導体製造装置を提供しています。そして現在、新たなお客さま層への新たなアプローチとして、従来とは異なる製品・分野の販路拡大を推し進めています。

そこで、電子機器の環境負荷を軽減する「グリーンデバイス」

へのニーズが高まっていることに着目し、これらの市場を対象に半導体機器事業で培ったコア技術を生かして、販路を開拓する取り組みを、「フロンティアプロジェクト」として立ち上げました。本プロジェクトは100億円程度の売上高を狙って2011年に本格スタートして以降、製品ラインアップを拡充しつつ、この数年順調に売上を伸ばしており、今後も成長が見込まれます。

ターゲット ▶ 半導体の需要をけん引するこれからの成長市場

主なアプリケーション(用途)

① スマートフォン



2018年末には世界の携帯電話出荷台数は25億台を超え、スマートフォンはそのうち90%近くを占めるとも言われています。

② カーエレクトロニクス



ハイブリッドカーや電気自動車、ADAS(先進運転支援システム)の普及など自動車の電装化に伴い、自動車向け半導体需要の拡大が見込まれます。

③ IoT (Internet of Things)*



エアコンなどの家電製品の遠隔操作や通信・制御による省エネ技術、車載通信による渋滞緩和などのほか、農業、エネルギー、医療などあらゆる分野での開発や製品化が進んでいます。

用語解説

ウエハー：シリコンなどの半導体の材料を、薄い円盤状に加工したもの。この上にICがつけられる。

IoT：Internet of Things (モノのインターネット)の略。パソコンなどのIT機器以外の“モノ”(電化製品など)に通信機能を持たせ、インターネット接続することを指す。

パワーデバイス：電力の制御や供給を行う半導体。ハイブリッドカーや家電、スマートフォンの電力制御など、省電力技術に活用される。

SAWデバイス：物質の表面を伝搬する弾性表面波(Surface Acoustic Wave)を利用し、携帯電話などの移動体通信に不可欠な高周波フィルターなどに使用される。

MEMS：Micro Electro Mechanical Systemsの略。半導体製造技術を応用した微細な電子機械システム、および関連技術の総称。スマートフォンでは、マイク、圧力センサーなど、幅広い用途に使用されている。

レジスト：半導体製造工程において、ウエハーに回路を形成するために使用される感光剤。

当社の製品例



省電力・高性能・超小型化が進む電子デバイス製造に対応

パワーデバイス*、SAWデバイス*、MEMS*、LEDなど

「80EX スプレーコーター」

スマートフォンや医療関連機器への需要が拡大しているMEMSなど立体構造を持つさまざまな電子デバイスの製造工程では、スプレー方式により、レジスト*などを基板に均一に塗布します。

2014年
10月発売

セミコンダクターソリューション事業

売上高 **1,104億円**（前年同期比 **1.8%減**）

営業利益 **103億円**（前年同期比 **115.8%増**）

- ロジックメーカー向けの売上は増加しましたが、ファウンドリー向けの売上は減少しました。
- 地域別の売上では、欧米向けは増加しましたが、台湾向けが減少しました。
- 営業利益は、変動費の削減や製品構成の変化、たな卸資産評価損の減少などにより、大幅に増加しました。

今後の見通しと取り組み

- 第4四半期は、半導体メーカーの積極的な設備投資により、売上増加を予想しています。
- 受注高についても、半導体メーカーの投資が継続すると予想しています。
- 改造、保守サービスなどのポストセールスや、フロンティアプロジェクト*関連製品の売上拡大にも注力していきます。

* 本誌「クローズアップ」をご覧ください。

ファインテックソリューション事業

売上高 **118億円**（前年同期比 **17.1%減**）

営業損失 **10億円**（前年同期は**2億円の営業損失**）

- テレビ向けの大型パネル用製造装置の売上は増加しましたが、スマートフォン・タブレット向け（高精細）中小型パネル用製造装置の売上が減少したことから、前年同期に比べ売上が減少しました。
- 売上が減少したことなどにより、前年同期に比べ営業損失は拡大しました。

今後の見通しと取り組み

- 一服感のあった第2四半期から受注高が大幅に改善し、第4四半期もこの水準が続くと見えています。
- 中国での投資は、大型パネル用製造装置から中小型用パネル製造装置へシフトしています。台湾でも中小型用装置を中心に投資が再開しています。

グラフィックアンドプレジジョンソリューション事業

売上高 **394億円**（前年同期比 **10.0%増**）

営業利益 **20億円**（前年同期比 **36.8%増**）

- 印刷関連機器については、海外を中心にCTP装置とPOD装置の需要が回復したことや、為替が円安に推移したことにより、前年同期に比べ売上が増加しました。
- プリント基板関連機器については、主力の直接描画装置の売上が増加したことにより、前年同期に比べ売上が増加しました。
- 営業利益は、売上が増加したことなどにより、前年同期に比べ増加しました。

今後の見通しと取り組み

- 印刷関連機器では、CTP装置の国内入れ替え需要がしばらく継続する見込みです。POD装置は北米で比較的安定しているほか、欧州では需要が回復基調にあります。
- プリント基板関連機器では、生産地のシフト（韓国・台湾から中国・東南アジアへ）に対応していきます。

用語解説

ロジック：

半導体の一種で、演算や命令などを行う。

ファウンドリー：

半導体の受託生産を行う企業。

CTP：

Computer to Plate（版）の略。印刷するデータをコンピューターから印刷用プレートに出力し、印刷版を作成する方法。

POD：

Print on Demandの略。必要なときに必要な部数を印刷すること。

直接描画装置：

回路パターンを高速・高精細に直接描画（露光）する装置。従来の露光方式に比べ、納期の短縮やコストの大幅な削減を可能にする。

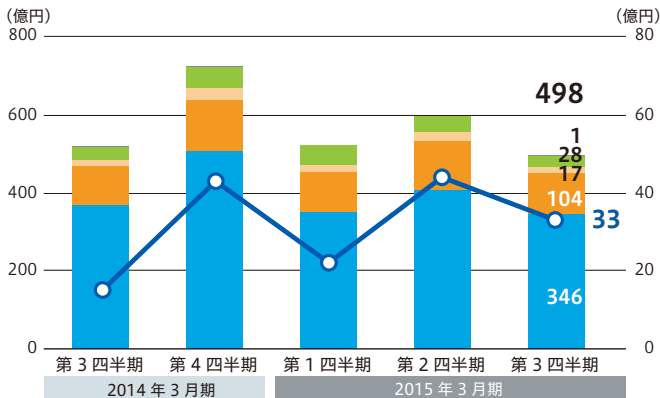
2015年3月期連結経営成績

(単位：億円未満切捨)

	第3四半期 2014年10月1日から 2014年12月31日まで	前年同期	第3四半期累計 2014年4月1日から 2014年12月31日まで	前年同期
売上高	498	521	1,623	1,632
営業利益	33	15	101	45
経常利益	28	14	93	40
四半期純利益	31	6	78	22

売上高・営業利益

■ セミコンダクターソリューション事業
 ■ グラフィックアンドプレジジョンソリューション事業 (■ 印刷関連機器 ■ プリント基板関連機器)
 ■ ファインテックソリューション事業 ■ その他 ● 営業利益[右目盛]



2015年3月期連結業績予想

(単位：億円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
通期	2,380	150	142	112

2015年3月期の期末配当につきましては、1株当たり5円を予定しております。

(注)財務数値につきましては、金額は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表記しております。

セグメント名称の変更について

2014年10月1日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、当第3四半期会計期間より、報告セグメント名称を下記のとおり変更しております。

- ・半導体機器事業 → セミコンダクターソリューション事業 (SE)
- ・メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業 → グラフィックアンドプレジジョンソリューション事業 (GP)
- ・FPD機器事業 → ファインテックソリューション事業 (FT)

TOPICS

個人投資家さま向けWebサイトのご案内

2015年3月中に、当社グループホームページに個人投資家さま向けサイトを立ち上げる予定です。当社グループの歩み、事業領域、強みやこれからの成長戦略などを一般の方に分かりやすいよう、ご紹介します。ぜひ、ご覧ください。



WEB 下記URLからアクセスできます。
www.screen.co.jp/ir/indiv/

株価および出来高の推移



UD FONT
by HIRAGINO

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しております。

株式会社 SCREENホールディングス

〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 電話075(414)7131
www.screen.co.jp 証券コード7735

SCREEN NOW Vol.94 発行日：2015年3月13日(発行は3月、6月、9月、12月) 発行：広報・IR室
 「SCREEN NOW」(株主通信)は、当社のフォント「ヒラギノ書体」を使用しております。